****

|  |  |
| --- | --- |
| **Leserkontakt:** | **Pressekontakt:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network** |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Telefon: +49-991-2700-0 | Telefon: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com[www.congatec.com](http://www.congatec.com/) | info@sams-network.com [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com)  |

*
Die neuen COM Express Compact Module von congatec mit Intel® Core™ Prozessoren der sechsten Generation (Codename Skylake) sind für die Auslegung komplett geschlossener, lüfterloser Systeme auf maximal 15 Watt konfigurierbare TDP optimiert.*

*Text und Foto auch online unter:* <http://www.congatec.com/presse>

Pressemitteilung 15/2015

 **congatec stellt neue COM Express Compact Module mit Intel® Core™ Prozessoren der sechsten Generation vor**

Neues Performance-Niveau für die 15 Watt Klasse der lüfterlosen Embedded Systeme

**Deggendorf, 2. September 2015 \* \* \*** Die congatec AG, führender Technologie-Anbieter für Embedded Computermodule, Single Board Computer (SBCs) und Embedded Design & Manufacturing (EDM) Services, stellt parallel zum Launch der Intel® Core™ Prozessoren der sechsten Generation (Codename Skylake) neue COM Express Compact Module vor, die speziell für lüfterlose, komplett geschlossene Systemdesigns ausgelegt sind. Die neuen Computermodule mit 15 Watt konfigurierbarer TDP sind hierfür ausschließlich mit den energiesparenden ULV-SoCs dieser neuen 14nm Mikroarchitektur bestückt. Anwender profitieren im Vergleich zur fünften Generation (Codename Broadwell) von einem klaren Mehr an Grafik- und Rechenleistung und gestiegener Energieeffizienz sowie deutlich mehr High-Speed I/Os.

Typische lüfterlose Applikationen für die neuen congatec COM Express Compact Module finden sich in den Bereichen Medizin und Bildverarbeitung, Steuerungstechnik und Fertigungs-Terminals, HMIs und Robotik, Gaming und Infotainment, Professional Audio und Video, smarte Videoüberwachung, autonome Fahrzeugsteuerung, computerunterstütze Situationsanalytik sowie in High-End Digital Signage Anwendungen. Ein weiteres typisches Anwendungsfeld sind grafikkartenlose Multi-Screen-Lösungen aller Art – beispielsweise im Bereich Retail und Kiosk bei denen ein Embedded System bis zu drei unabhängige Bildschirme bei Kassen oder Verkaufsautomaten steuern kann.

„Wir haben die neuen conga-TC170 COM Express Compact Module parallel zum Launch der neuen Intel Core Prozessoren verfügbar gemacht, da unsere Kunden schnell mit neuester Technik auf den Markt kommen wollen“, erklärt Gerhard Edi, CTO bei congatec.

"congatecs neue Computer-on-Module mit Intel Core Prozessoren der 6ten Generation bieten extrem schnelle Computing- und Grafik-Performance, zusätzliche High-Speed-I/Os für größere Systemflexibilität sowie eine breite Palette an Leistungs-, Funktions- und Performance-Optionen, um jeder IoT-Anwendung gerecht zu werden", so Samuel Cravatta, Product Line Director der Internet of Things Group, Intel.

Anwender profitieren von der hohen Standardisierung und Skalierbarkeit der COM Express Module sowie der bei congatec üblichen umfassenden Dokumentation, industriegerechter Treiberimplementierungen und persönlichem Integrationssupport, sodass OEMs neueste Prozessortechnologie besonders schnell und effizient in ihre individuellen Applikationen integrieren können. Alle Module werden zudem mit einer Langzeitverfügbarkeit und einem Softwaresupport von mindestens sieben Jahren angeboten. Der Softwaresupport beinhaltet unter anderem fortschrittliche Sicherheitsfeatures sowie kontinuierliche UEFI/BIOS Updates und BSP Patches. Über den gesamten Lebenszyklus einer Applikationen hinweg profitieren Kunden von diesem Support.

**Die technischen Innovationen im Detail**

Die conga-TC170 Module mit COM Express Type 6 Pinout sind mit den ULV-SoC Editionen der sechsten Generation Intel Core i3/i5/i7 Prozessoren bestückt. Sie bieten erstmals eine konfigurierbare TDP (Thermal Design Power) von 7,5 bis 15 Watt, was die Anpassung der Applikation an das Energiekonzept des Systems erleichtert. Die Spannungsversorgung wurde zudem optimiert, was neben der neuen Mikroarchitektur ebenfalls zur Steigerung der Energieeffizienz beträgt und zudem auch eine ausgedehnte Nutzung des Turbo-Boost ermöglicht.

Neu ist auch der Support von bis zu 32 GB schnellen Dual Channel Speichers, der in DDR4 Auslegung deutlich bandbreitenstärker und energiesparender ist als bisher übliche DDR3 Implementierungen.

Die erstmals mit der neuen Mikroarchitektur verfügbare Intel Gen 9 Grafik versorgt bis zu drei unabhängig betriebene 4k Displays mit 60 Hz via DisplayPort 1.2. Unterstützt wird zudem erstmals HDMI in der Version 2.0 sowie DirectX in der Version 12 für noch schnellere Windows 10 basierte 3D Grafik. Da nun nicht nur die Decodierung sondern auch die Encodierung von HEVC, VP8, VP9 und VDENC hardwareseitig unterstützt wird, ist erstmals das energieeffiziente Streaming von HD-Videos in beide Richtungen möglich. Weitere Verbesserungen gibt es bei der Anzahl der USB 3.0 Schnittstellen (jetzt 4) SATA Gen 3 (jetzt 3) PCIe Gen 3 (jetzt 6) sowie AMT (jetzt Version 11.0).

Die neuen congatec Computermodule unterstützen zudem COM Express Type 6 Pin-Out mit PEG, Gigabit Ethernet, 8x USB 2.0, LPC sowie I²C und UART. Dank optionalem MIPI Kamerainterfaces können auch CSI2 Kamerasensoren direkt angebunden werden. Betriebssystem-Support wird für alle gängigen Linux Distributionen und Microsoft Windows Varianten geboten – Microsoft Windows 10 inklusive. Umfangreiches, das Design-In erleichterndes Zubehör – wie Kühllösungen, Carrierboards und Starterkits sowie SMART Battery Management Module – rundet das Angebot ab.

Verfügbar sind ab sofort folgende CPU Versionen:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prozessor**  |  | **Cores/****Threads** |  | **Smart Cache** |  | **Clock** |  | **Turbo Boost** |  | **TDP/cTDP** |  | **Grafik** |  | **AMT** |
| **Intel® Core™ i7-6600U**  |  | **2/4** |  | **4 MB** |  | **2,6 GHz**  |  | **3,4 GHz** |  | **15/7.5 W** |  | **GT2 520****300-1050 MHz** |  | **11.0** |
| **Intel® Core™ i5-6300U**  |  | **2/4**  |  | **3 MB** |  | **2,4 GHz** |  | **3,0 GHz** |  | **15/7.5 W** |  | **GT2 520300-1000 MHz** |  | **11.0** |
| **Intel® Core™ i3-6100U**  |  | **2/4**  |  | **3 MB** |  | **2,3 GHz** |  | **-** |  | **15/7.5 W** |  | **GT2 520300-1000 MHz** |  | **-** |

Das Datenblatt und weitere Informationen zum neuen conga-TC170 Computermodulen unter: <http://www.congatec.com/de/produkte/com-express-typ6/conga-tc170.html>

**Über die congatec AG**

Mit Hauptsitz in Deggendorf, Deutschland ist die congatec AG ein führender Anbieter von industriellen Computermodulen auf den Standard-Formfaktoren Qseven, COM Express, XTX und ETX, sowie für Single Board Computer und EDM-Services. Die Produkte und Dienstleistungen des innovativen Unternehmens sind branchenunabhängig und werden z.B. in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik, im Entertainment, im Transportwesen, bei Telekommunikation, Test & Measurement sowie Point-of-Sale Anwendungen eingesetzt. Wesentliche Kernkompetenzen sind besondere, erweiterte BIOS- und Treiberunterstützung und umfangreiche Board Support Packages. Die Kunden werden ab der Design-In Phase durch umfassendes Product Lifecycle Management betreut. Die Fertigung der Produkte erfolgt bei spezialisierten Dienstleistern nach modernsten Qualitätsstandards. congatec unterhält Niederlassungen in Taiwan, Japan, China, USA, Australien und Tschechien. Weitere Informationen finden Sie unter [www.congatec.de](http://www.congatec.de) oder bei [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) und [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

Die congatec AG ist ein ‚Associate Member‘ der ‚Internet of Things Solutions Alliance‘. Intel und weltweit mehr als 350 Mitgliedsunternehmen bieten im Rahmen dieser Allianz skalierbare, interoperable Lösungen an, die eine beschleunigte Einführung von intelligenten Geräten und End-to-End-Analytik ermöglichen. Die Mitglieder der Allianz profitieren von der engen Zusammenarbeit mit Intel und den beteiligten Unternehmen: Sie können auf Basis neuester Technologien Innovationen vorantreiben und ihre Lösungen als erste auf den Markt bringen.

\* \* \*

*Intel sowie Intel Core und Celeron sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.*